

X-Section Analyzer-I

Cutting/Grinding system for IC package defect analysis



本装置は、不良解析を目的としたICパッケージorチップ基板専用の切断・研削加工装置です。工具には、断面切断用カッターと表面研磨用バフを用意し、切断に必要な箇所を顕微鏡でダイレクトに観察しながら加工を行うことができます。専用設計によりコンパクトなフットプリントを実現し、コストパフォーマンスにも大変優れた装置です。

This system is cutting and grinding tool for IC package, chip defect analysis.

It can be applied cross section cutting and surface buff grinding tool. And the process can be inspected by microscope in real time. Special design and small package realizes high performance with low cost.

主仕様

- 主軸 2000~60000rpm(取付 コレット式 φ6軸)
- 装置寸法 W420×D375×H700mm
- 顕微鏡 ×10~×40 LED照明付 3眼式(カメラ取付可)
- テーブル X/Yモーター駆動 S・T 各25mm(プログラマブルコントロール)
- 入力 AC100V
- タッチパネル 4.7incモノクロ

Specification

- Machining axis: 2000 to 60000 rpm (6mm dia. collet chuck)
- Machine dimension: W420×D375×H700mm
- Micro scope: x10 to x40, LED light, three eye glass (camera can be attached.)
- Table: X/Y manipulator. Travel: 25mm
- Power: AC100V

 **株式会社 ピーエムティー**

本社

〒811-2115 福岡県粕屋郡須恵町大字佐谷1705-1
TEL 092-933-3110 FAX 092-933-3115

東京営業所

〒144-0052 東京都大田区蒲田5-36-2 相互蒲田ビル5F
TEL 03-5744-8803 FAX 03-5744-8804

MAT Polish Analyzer-I

Polish Analyze R&D Tool integrated all function in one package



研磨ステージ
Polishing stage



測定ステージ
Thickness measuring stage



観察ステージ
Visual stage

MATのポリッシュアナライザーは、従来の試料研磨装置とは異なる目線で設計致しました。ズーム顕微鏡を搭載しているため、結果を確認しながら研磨加工ができます。また、ステージ角度調整機能によりレイヤーごとの正確な研磨加工が可能のため、高精度な試料作成が誰でも簡単に実現できます。

MAT polish analyzer developed as break through design from conventional chip polishing tool. it can monitor the visual by zoom microscope and feed back to polishing process.

The angle adjustment function provides precise polishing and it can realize "turn-key" of sample making.

主仕様

- 定盤 φ200mm SUS(交換用プレート付き)
- 研磨軸 3Position 移動(研磨ステージ・測定ステージ・観察ステージ)
- 測定 厚み測定器・顕微鏡・顕微鏡モニター
- 基板貼付部 表面・端面研磨用アタッチメント
- フットプリント W820×D600×H1620mm(置台W750×D600×H800mm)
- 重量 300Kg

Specification

- Platendia.: 200SUS
- Polishing stage: 3 axis positioning (polishing, measuring, and visual inspection)
- Thickness measuring stage and microscope monitoring is equipped.
- Chip bonding tool: top surface and edge polishing attachment
- Foot print: H820×D600×H1620 (mount stage:W750×D600×H800mm)

販売元